

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 2 部門第 1 区分
 【発行日】平成 17 年 12 月 22 日 (2005.12.22)

【公表番号】特表 2004-527370 (P2004-527370A)
 【公表日】平成 16 年 9 月 9 日 (2004.9.9)
 【年通号数】公開・登録公報 2004-035
 【出願番号】特願 2002-583104 (P2002-583104)
 【国際特許分類第 7 版】

B 0 5 D 1/28

B 0 5 B 5/08

B 0 5 D 1/04

【 F I 】

B 0 5 D 1/28

B 0 5 B 5/08 B

B 0 5 D 1/04 Z

【手続補正書】
 【提出日】平成 17 年 2 月 3 日 (2005.2.3)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

液体で濡らした導電性転写表面へ液滴を静電スプレーする工程と、このように施された液体の一部を前記転写表面から基材に転写して、湿潤コーティングを形成する工程と、を含む基材上に液体コーティングを形成する方法。

【請求項 2】

コーティング組成物で濡らすと、コーティングの一部を基材へ転写することのできる導電性転写表面と、前記コーティング組成物を前記導電性転写表面に施すための静電スプレーヘッドと、を含む装置。

【請求項 3】

前記基材上の異なる位置で前記湿潤コーティングを周期的に接触および再接触することのできる 2 台以上のピック・アンド・プレース装置をさらに含み、前記基材上の前記コーティングの均一性を改善するように前記装置の周期が選択される、請求項 2 に記載の装置